



2026年5月18日

新レジスト樹脂工場および新研究棟の建設開始について

ハリマ化成グループ株式会社

ハリマ化成グループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：長谷川吉弘、以下、当社）は、生成 AI の普及を背景とした半導体需要の拡大に伴い、半導体レジスト用樹脂の生産能力および研究開発の一段の強化を目的として、加古川製造所内に新工場および新研究棟の建設を決定しました。

2026年6月に着工し、2027年6月の竣工を予定しています。



新工場



新研究棟

建設場所	兵庫県加古川市野口町水足 671-4 (ハリマ化成 加古川製造所内)
延床面積／構造	工場：約 750 平方メートル／鉄骨造 2 階建て 研究棟：約 1,400 平方メートル／鉄筋コンクリート造 3 階建て
主な施設	工場：反応釜、クリーンルーム、分析室 他 研究棟：実験室、クリーンルーム、会議室 他
スケジュール	着工：2026年6月 竣工：2027年6月 試験製造開始：2027年7月 量産開始：2028年6月

新工場「レジスト樹脂工場」の建設により、半導体レジスト用樹脂の製造能力は稼働初年度に現在の約 2 倍となります。また、将来的には設備増設により更なる拡張が可能な設計にしています。

設備面では、次世代製品に対応可能なクリーンルームと高精度自動制御設備を導入します。また、工程内検査を強化するための分析室を併設し、原材料貯蔵所の新設により原料品質の安定化と物流の効率化を実現させたスマートファクトリー化を進めます。

併設する新研究棟「中央研究所3号館」では、日々進化する半導体に即応する新素材・新材料の開発に取り組めます。研究テーマの探索から材料設計、評価、新工場での量産試作までを一体的に行うことで、顧客ニーズに即した材料提案と迅速な製品化を可能にします。

設備面では、超高清浄クリーンルームに加え、レジスト材料開発専用の実験室を整備することで、不純物混入防止対策が求められる次世代製品の開発力・提案力の強化を図ります。

当社の半導体レジスト用樹脂は、顧客の要望に対し、開発から提案、製造、納品までを一体で行う、スピード感あるものづくりを強みとしています。約30年にわたり培ってきた開発・製造技術の蓄積を背景に、ここ10年で事業は大きく成長してきました。新工場と新研究棟の建設により、顧客へのより迅速なフィードバックが可能となり、開発から品質管理までの一体化をさらに強化します。

これにより、需要増への対応に加え、品質の安定化とさらなる高品質化が実現します。また、より厳しい管理基準が求められる先端パッケージを含む後工程分野についても、開発・供給体制の強化を進めていきます。

当社の半導体レジスト用樹脂の受注は年々増加しており、計画を上回る水準で推移しています。また、半導体の用途拡大や製造プロセスの高度化により、レジスト材料に求められる性能や管理水準は一層厳しくなっています。

今後は、成長が見込まれるレジスト材料を中心に、高付加価値領域での事業拡大を進めるとともに、将来的には他の半導体材料分野への展開も視野に入れ、当社半導体材料事業のさらなる成長を目指してまいります。

以上

本件に関するお問い合わせ先
ハリマ化成グループ株式会社
広報グループ
TEL : 06-6201-2477
URL : <https://www.harima.co.jp/contact/>